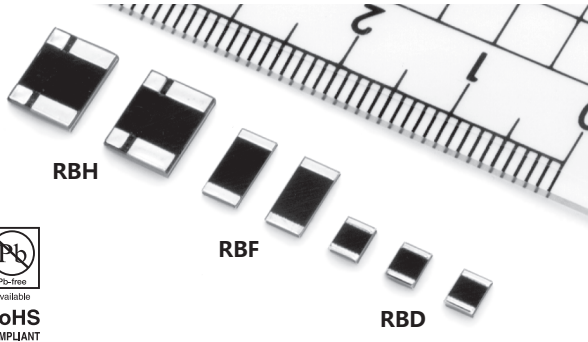


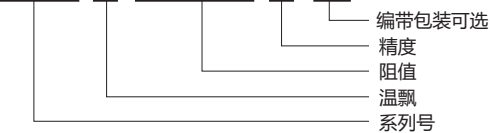
超精密表面贴装电流检测电阻 (倒装芯片)



选型表

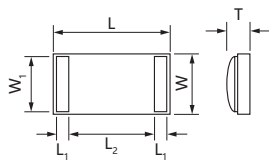
选型举例:

RBF J R1000 F L



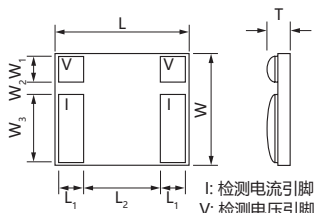
用5位代码表示阻值, 4位代码是有效数字。R或K表示阻值范围 (R代表欧姆, K代表千欧姆) 和小数点的位置。

结构图



系列	RBD	RBF
L	3.2±0.1	6.3±0.1
W	2.5±0.1	3.2±0.1
L ₁	0.5±0.2	0.7±0.2
L ₂	2.1±0.2	4.7±0.2
W ₁	2.4±0.2	3.0±0.2
T	1.05 max.	

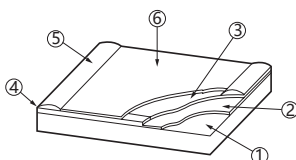
尺寸单位(mm)



形式	RBH
L	7.5±0.1
W	6.0±0.1
L ₁	1.4±0.2
L ₂	4.4±0.2
W ₁	1.4±0.2
W ₂	0.7±0.2
W	3.6±0.2
T	1.5 max.

尺寸单位(mm)

结构



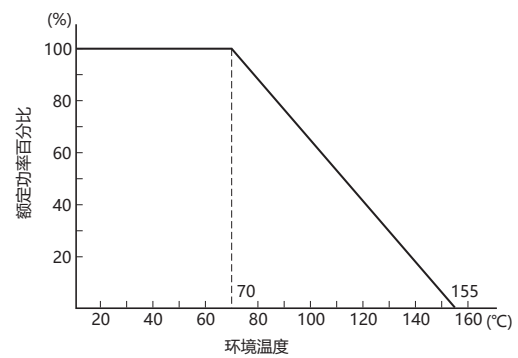
- ① 陶瓷基底(高纯度氧化铝)
- ② 耐热粘接层
- ③ 金属箔(Bulk Metal® Foil)
- ④ 金属镀层
- ⑤ 焊锡
- ⑥ 阻焊层

温度系数, 阻值范围, 精度, 额定功率

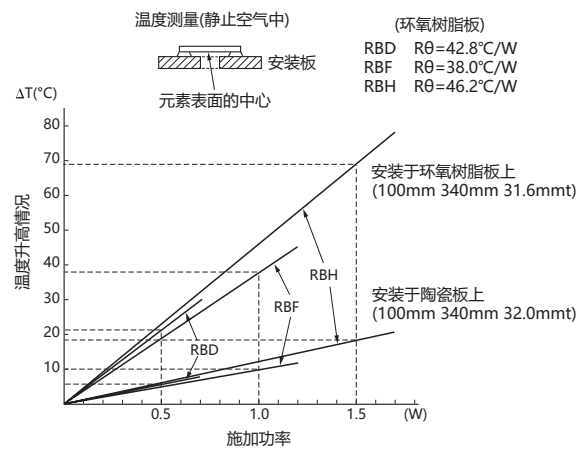
系列号	温度系数 (ppm/°C) -25°C ~ 125°C*	阻值范围 (Ω)	阻值精度 (%)*	额定功率 (W) 70°C
RBD	0±25 (J)	0.01 ~ 0.1	±1 (F)±2 (G) ±5 (J)	0.5
	0±10 (C) 0±25 (J)	0.1 ~ 1	±0.5 (D)±1 (F) ±2 (G)±5 (J)	
RBF	0±25 (J)	0.01 ~ 0.1	±1 (F)±2 (G) ±5 (J)	1
	0±10 (C) 0±25 (J)	0.1 ~ 1	±0.5 (D)±1 (F) ±2 (G)±5 (J)	
RBH	0±10 (C) 0±25 (J)	0.01 ~ 0.1	±0.5 (D)±1 (F) ±2 (G)±5 (J)	1.5

* 括号内的代码用于选型表

降功耗曲线



电阻表面温度



在2W, 70°C情况下持续工作时请使用金属化的基板
使用环氧釉板时请保持温度低于90°C。

性能参数			
项目	测试条件	ALPHA参数	ALPHA典型测试数据
最大额定工作温度 工作温度范围			70°C -65°C ~ +155°C
热冲击 过载	-65°C/30 min. ↔ +155°C/30 min., 5次循环 额定功率 x 2.5, 5 sec.	±0.1% ±0.1%	±0.03% ±0.03%
低温存储和工作 基板弯曲测试	-65°C, 无负载, 24 hrs. → 额定电压, 45 min. 基板弯曲 3 mm, 60 sec.	±0.1% ±0.1%	±0.05% ±0.05%
绝缘电阻 绝缘电阻特性 耐湿性	大气压下: AC 200V, 1 min. DC 100V, 1 min. 260°C, 10 sec. +65°C ~ -10°C, 90% RH ~ 98% RH, 额定电压, 10次循环 (240 hrs.)	±0.05% 大于 10,000 MΩ ±0.1% ±0.1%	0.01% 大于 10,000 MΩ ±0.03% ±0.03%
冲振动, 高频	100G, 6 ms, 锯齿波, X, Y, Z, 各10次循环 20G, 10 Hz ~ 2,000 Hz ~ 10 Hz, 20 min., X, Y, Z, 各2.5 hrs.	±0.05% ±0.05%	±0.01% ±0.01%
寿命	70°C, 额定功率, 1.5 hr. - ON, 0.5 hr. - OFF, 2,000 hrs	±0.1%	±0.05%
存储寿命	15°C ~ 35°C, 15% RH ~ 75% RH, 无负载, 10,000 hrs.	±0.05%	±0.01%
高温暴露	155°C, 无负载, 2,000 hrs.	±0.1%	±0.05%

编带包装(基于EIA-481-1)																		
编带尺寸										包装盘尺寸								
RBD, RBF: 0.2560.05 RBH: 0.3060.05 RBD, RBF: 1.260.1 RBH: 1.8060.1																		
系列	A ₀	B ₀	W	F	E	P ₁	P ₂	P ₀	D ₀	系列	A	N	B	C	D	W ₁	W ₂	r
RBD	2.85 ±0.1	3.7 ±0.1	8.0 ±0.2	3.5 ±0.05	1.75 ±0.1	4.0 ±0.1	2.0 ±0.05	4.0 ±0.1	Φ1.5 +0.1-0	RBD	Φ178 ±2	Φ60 min.	Φ13 ±0.5	Φ21 ±0.8	2.0 ±0.5	8.4 +2.0-0	14.4 max.	1.0 ±0.5
RBF	3.4 ±0.1	6.7 ±0.1	12.0 ±0.2	5.5 ±0.05	1.75 ±0.1	4.0 ±0.1	2.0 ±0.05	4.0 ±0.1	Φ1.5 +0.1-0	RBF	Φ178 ±2	Φ60 min.	Φ13 ±0.5	Φ21 ±0.8	2.0 ±0.5	12.4 +2.0-0	18.4 max.	1.0 ±0.5
RBH	6.3 ±0.1	7.8 ±0.1	16.0 ±0.2	7.5 ±0.1	1.75 ±0.1	8.0 ±0.1	2.0 ±0.1	4.0 ±0.1	Φ1.5 +0.1-0	RBH	Φ178 ±2	Φ60 min.	Φ13 ±0.5	Φ21 ±0.8	2.0 ±0.5	17.0 ±0.3	19.4 ±0.1	1.0 ±0.5
										编带容量 RBH: 1,000 pcs/盘 RBD, RBF: 4,000 pcs/盘								
										尺寸单位(mm)								

使用表面贴装电流检测电阻注意事项																																		
<p>1. 存储 存储条件或环境可能对电阻引脚的可焊性产生影响。不可存储于高温和高湿环境。建议存储于温度低于40°C, 湿度低于70%RH的环境, 避免接触硫磺气体和含氯气体等。</p> <p>2. 焊接注意事项</p> <p>① 回流焊接 建议 • 最高温度: 250+0/-5°C • 高温时间: 10 sec. max. • 室温下冷却</p> <p>② 浸焊 (波峰或静止) 建议 • 焊接温度: 260°C max. • 浸入时间长: 10 sec.</p> <p>③ 其他 推荐无腐蚀焊剂, 比如松脂。焊接后, 不可立即给模压外壳施加应力。</p> <p>3. 清洁 使用挥发性清洁剂比如甲醇或者异丙醇。</p> <p>4. 电路板设计</p> <p>① 推奨ランド寸法 焊盘尺寸 焊接面积取决于电阻尺寸和焊接方法, 也受贴装设备和基板材料的影响, 如右图。</p>																																		
<p>② 电路设计 推荐电路如下图所示, 以便使电流从一个方向接近, 通过, 离开贴装电阻。如有条件, 可使用更厚的铜箔。</p>																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">系列号</th> <th colspan="5">尺寸单位(mm)</th> </tr> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> <th>E</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RBD</td> <td>2.6 ~ 2.8</td> <td>0.8</td> <td>2.0</td> <td rowspan="2">/</td> <td rowspan="2">/</td> </tr> <tr> <td>RBF</td> <td>3.4 ~ 3.6</td> <td>1.2</td> <td>4.5</td> </tr> <tr> <td>RBH</td> <td>3.8 ~ 4.0</td> <td>2.0</td> <td>4.0</td> <td>0.5</td> <td>1.7</td> </tr> </tbody> </table>						系列号	尺寸单位(mm)					A	B	C	D	E	RBD	2.6 ~ 2.8	0.8	2.0	/	/	RBF	3.4 ~ 3.6	1.2	4.5	RBH	3.8 ~ 4.0	2.0	4.0	0.5	1.7		
系列号	尺寸单位(mm)																																	
	A	B	C	D	E																													
RBD	2.6 ~ 2.8	0.8	2.0	/	/																													
RBF	3.4 ~ 3.6	1.2	4.5																															
RBH	3.8 ~ 4.0	2.0	4.0	0.5	1.7																													

免责声明

所有产品、产品说明书以及数据均可在不作另行通知的情况下更改。

Vishay Precision Group, Inc. 及其附属单位、代理商、雇员以及其他代表其行事的任何人（合称为“VPG”）不因本协议项下或其他披露中与产品相关的信息的任何错误、不准确及不完整等承担任何法律责任。

产品说明书不构成对VPG中采购条款与条件的扩展或修订，包括但不限于本协议项下的保证。

除采购条款和条件中有特别说明外，VPG不作任何保证、陈述以及担保。

在适用法律许可的最大范围内，VPG特作出如下免责声明：(i)因产品使用而造成的所有责任，(ii)包括但不限于特殊、间接或附带损害产生的所有责任，(iii)所有默示的保证，包括对特殊用途的适宜性、无侵权的可能性和可销性的保证。

规格书和参数表提供的信息在不同的应用中会有差异，并且随着时间的推移，产品的性能可能发生变化。对于产品的推荐应用说明是基于VPG对于典型需求的认知和经验。顾客有义务根据产品说明书中所提供的参数去验证该产品是否适用于某个具体的应用。在正式安装或使用产品之前，您应确保已获取相关信息的最新版本，您可以通过vpgsensors.com的网站获得。

本协议的签署不构成对VPG产品所有知识产权相关的明示、默示或其他形式的许可。

除非另有明确指出，本协议所列的产品不适用于救生或维持生命的产品。在无明确指出的情况下，顾客擅自使用在上述产品中造成的一切风险由其自行承担，并且同意全额赔偿VPG因该种销售或使用带来的一切损失。针对此类特殊应用的产品书面条款，请联系已授权的VPG有关人员获得。

所列产品标注的名称以及标记可能为他人所有的商标。

Copyright Vishay Precision Group, Inc., 2014. All rights reserved.